

电子

周跟踪 (20240701-20240707)

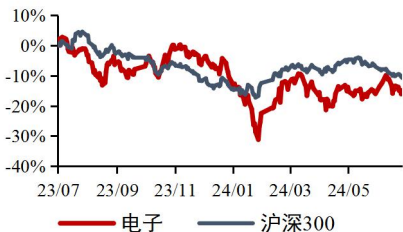
领先大市-A(维持)

Q3 服务器出货动能增强, H2 晶圆厂产能利用率有望提升

2024年7月8日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源: 最闻

相关报告:

【山证电子】三星上调 DRAM 和 NAND 价格, 美光 24Q3 业绩实现高增长-山西证券电子行业周跟踪 2024.7.1

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪: 周期上行需求回暖, 制造端涨价信号频现 2024.6.24

分析师:

高宇洋

执业登记编码: S0760523050002

邮箱: gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码: S0760522050001

邮箱: xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体:** 本周(2024.07.01-2024.07.05)市场总体下跌, 上证指数跌 0.59%, 深圳成指跌 1.73%, 创业板指数跌 1.65%, 科创 50 跌 1.86%, 申万电子指数跌 2.96%, Wind 半导体指数跌 2.97%, 费城半导体指数涨 3.36%, 台湾半导体指数涨 3.01%。细分板块中, 周涨跌幅前三为半导体材料(-1.31%)、半导体设备(-1.75%)、电子化学品(-2.53%)。从个股看, 涨幅前五为: 经纬辉开(+25.43%)、显盈科技(+24.81%)、则成电子(+21.16%)、铜冠铜箔(+19.27%)、光华科技(+17.37%); 跌幅前五为: 百邦科技(-26.21%)、满坤科技(-25.63%)、恒烁股份(-21.15%)、瀛通通讯(-18.71%)、安路科技(-18.06%)。

➢ **行业新闻: 2024年下半年半导体晶圆厂利用率有望突破80%。**受益于HBM的旺盛需求以及AI数据中心对NAND闪存使用量的增长, 当前存储市场表现亮眼。台积电5纳米及以下先进制程的产能利用率已接近饱和。但工业和汽车市场的情况仍不明朗。模拟芯片等领域制造商在2024H1被迫削减产量, 成熟制程晶圆厂产能利用率并不理想。预计随着库存消化和终端需求全面复苏, TechInsights 预计2024H2全球晶圆厂利用率有望提升至80%左右, 2025年将达到平均90%。**上游供应链库存回补及需求增温, 第三季服务器出货预计增长4-5%。**据TrendForce, 除已知的AI服务器订单需求畅旺外, 近期受益于招标项目所驱动, 以及AI所牵引的储存服务器需求助力, 服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势, 预估第三季增长约为4-5%。**SK海力士将投资750亿美元推进AI, 其中80%注入HBM。**6月30日韩国SK集团宣布, 其芯片制造商SK海力士将在2028年之前投资103万亿韩元(约合750亿美元)来增强其芯片业务(尤其是人工智能业务)。投资额的80%, 约合82万亿韩元(600亿美元), 将专门用于开发HBM。

➢ **重要公告: 【景旺电子】**预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元, 与上年同期相比, 将增加23,401万元到29,780万元, 同比增加57.94%到73.74%。**【世运电路】**预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为27,500万元到31,500万元, 与上年同期相比, 将增加7,904.25万元到11,904.25万元, 同比增加40.34%到60.75%。**【韦尔股份】**预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为130,779.21万元到140,779.21万元, 同比增加754.11%到819.42%。

投资建议

➢ 受益AI带动, 当前存储及服务器市场需求持续旺盛, 但工业和汽车市场情况仍不明朗, 成熟制程晶圆厂产能利用率暂不及理想水平。随着库存消化和终端需求的全面复苏, 预计2024H2全球晶圆厂利用率有望提升至80%左右。建议关注设备、材料、零部件的国产替代, AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求, 及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
4. 风险提示.....	11

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅半导体材料、半导体设备、电子化学品表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅元件、消费电子、半导体设备表现领先.....	5
图 5： 半数板块当前 P/E 在历史平均值附近.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 低于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6

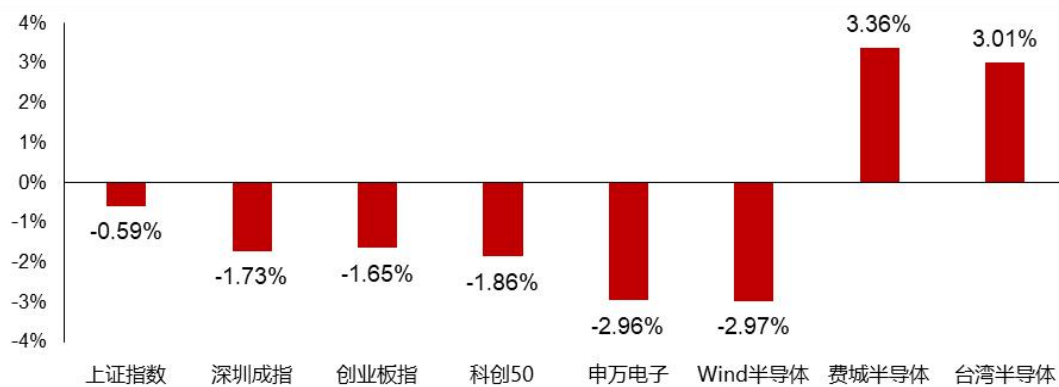
图 10: 分地区半导体销售额.....	6
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	7
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货平均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.07.01-07.05）市场总体下跌，上证指数跌 0.59%，深圳成指跌 1.73%，创业板指数跌 1.65%，科创 50 跌 1.86%，申万电子指数跌 2.96%，Wind 半导体指数跌 2.97%，费城半导体指数涨 3.36%，台湾半导体指数涨 3.01%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

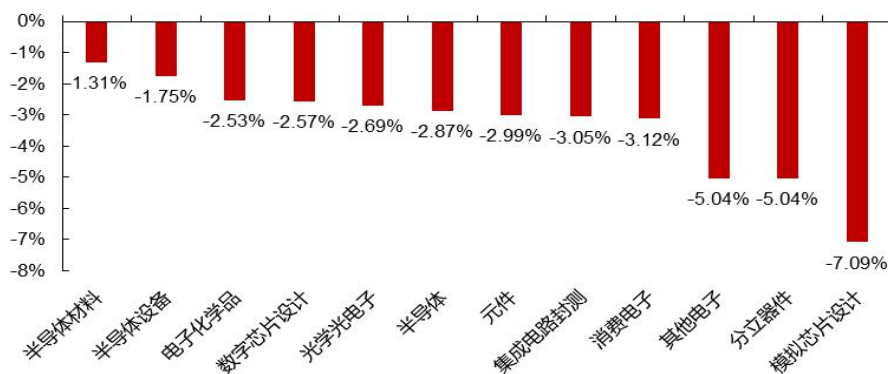


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

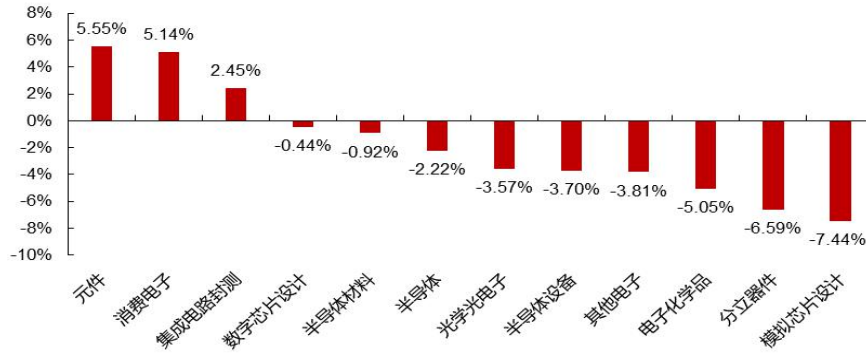
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体材料、半导体设备、电子化学品表现领先



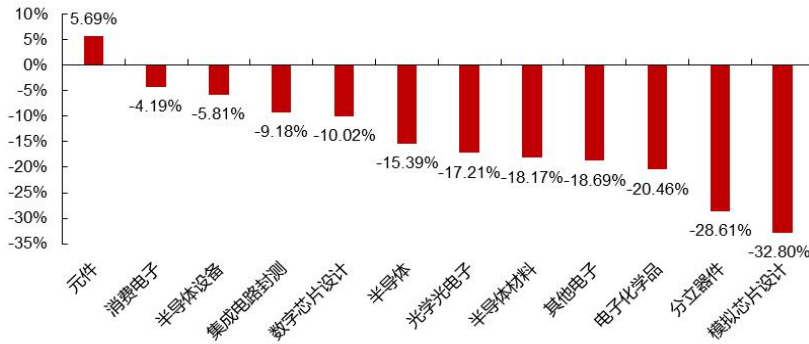
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅元件、消费电子、集成电路封测表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

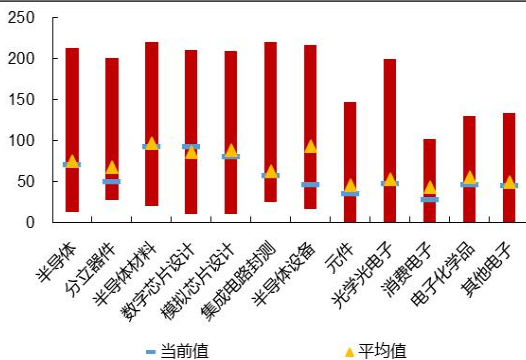
图 4：年初至今涨跌幅元件、消费电子、半导体设备表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

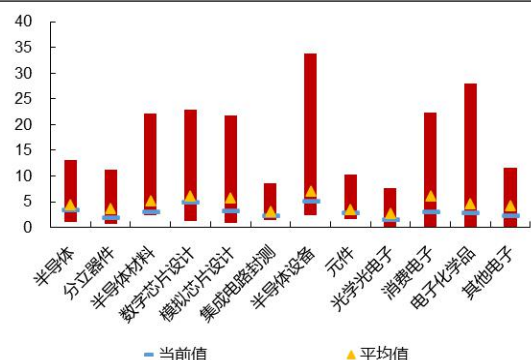
1.2.2 估值

图 5：半数板块当前 P/E 在历史平均值附近



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均值

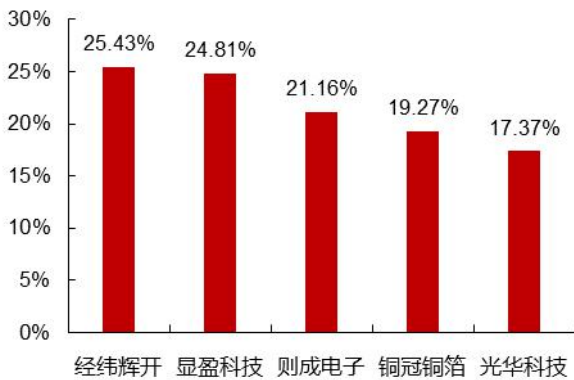


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

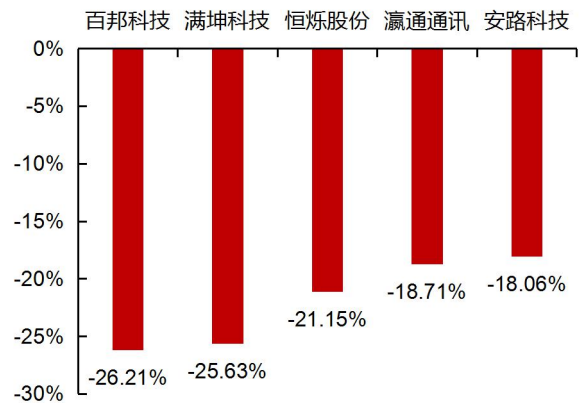
从个股情况看，经纬辉开、显盈科技、则成电子、铜冠铜箔、光华科技涨幅领先，涨幅分别为25.43%、24.81%、21.16%、19.27%、17.37%；百邦科技、满坤科技、恒烁股份、瀛通通讯、安路科技跌幅居前，跌幅分别为-26.21%、-25.63%、-21.15%、-18.71%、-18.06%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

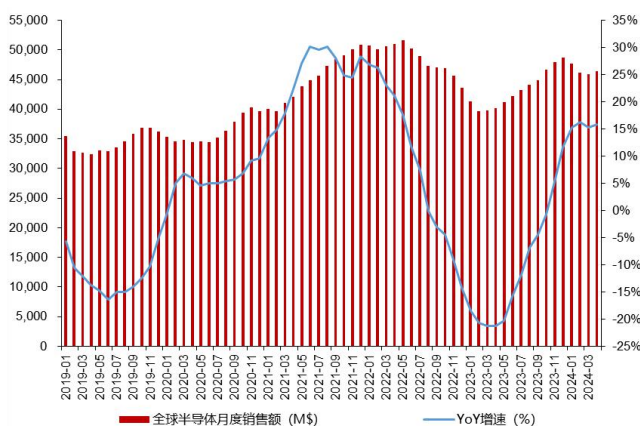
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

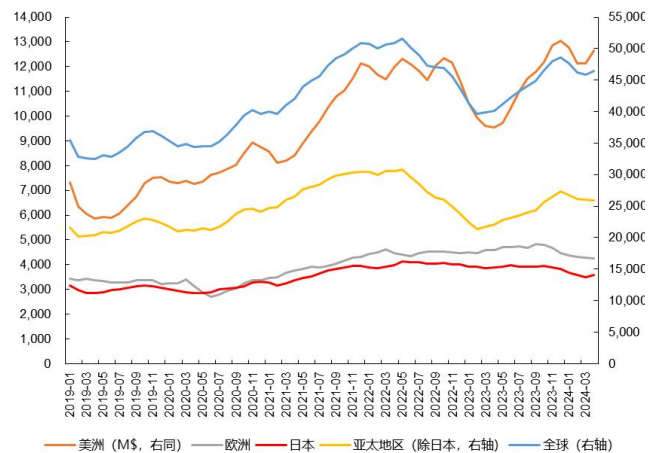
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



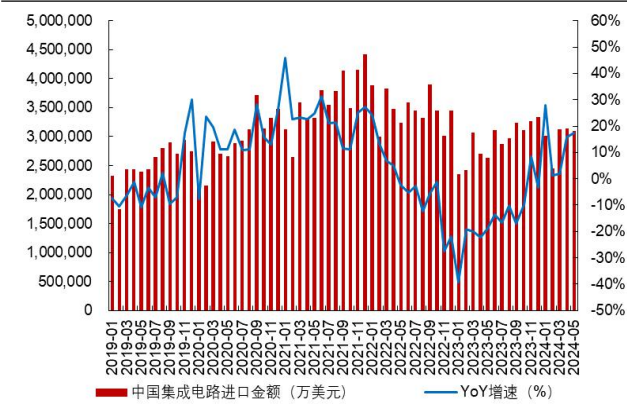
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



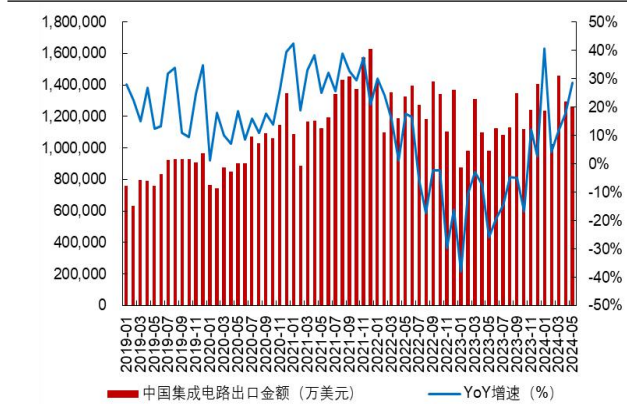
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11: 中国集成电路行业进口情况



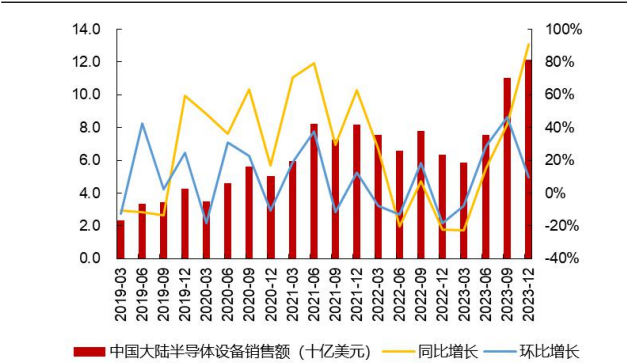
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 12: 中国集成电路行业出口情况



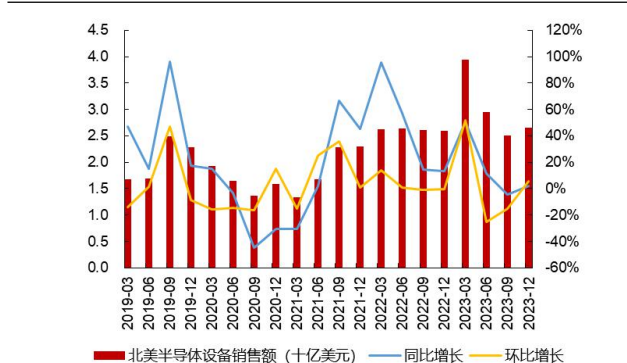
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 13: 中国大陆半导体设备销售额



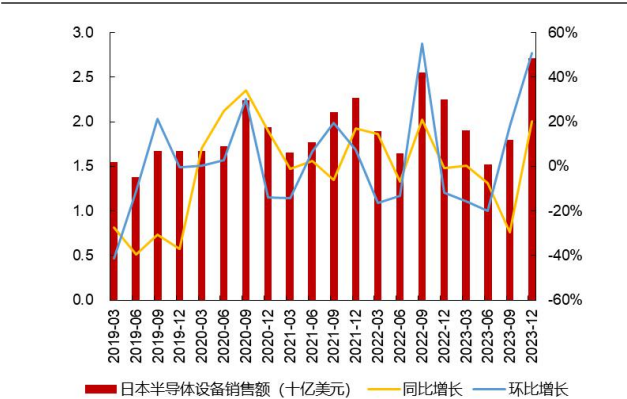
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 14: 北美半导体设备销售额



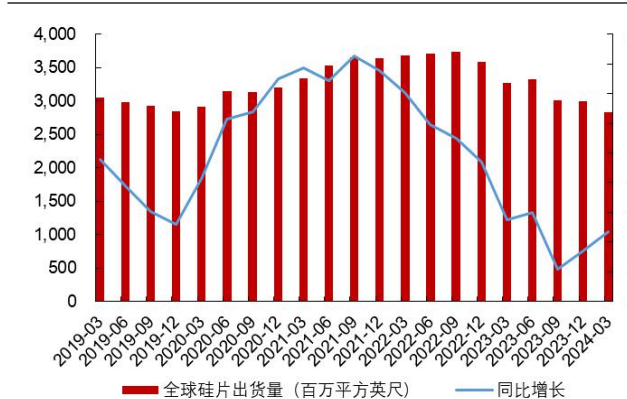
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



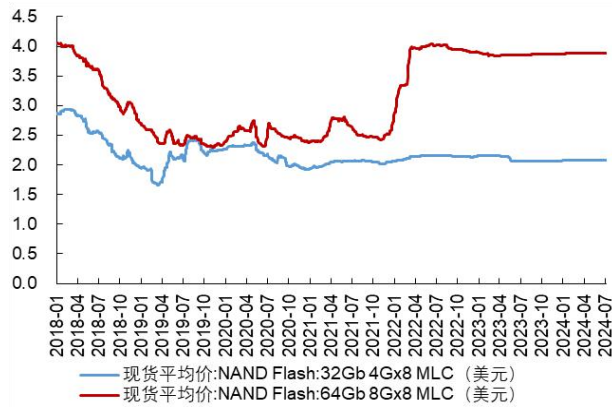
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



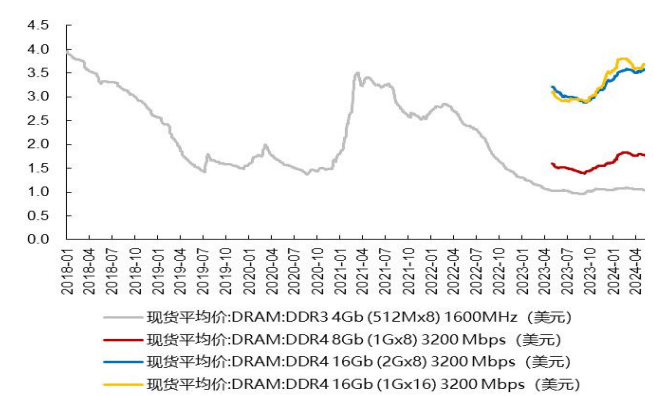
资料来源: SEMI, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



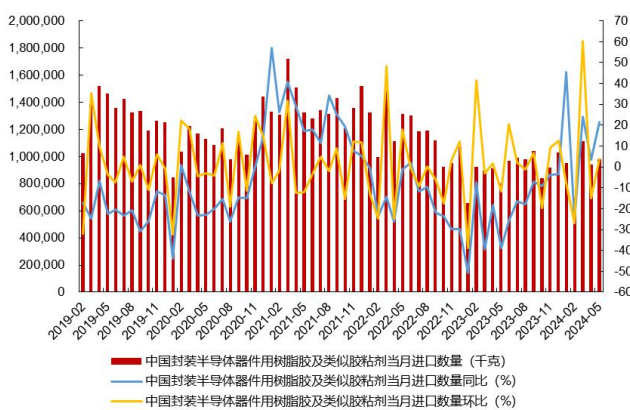
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



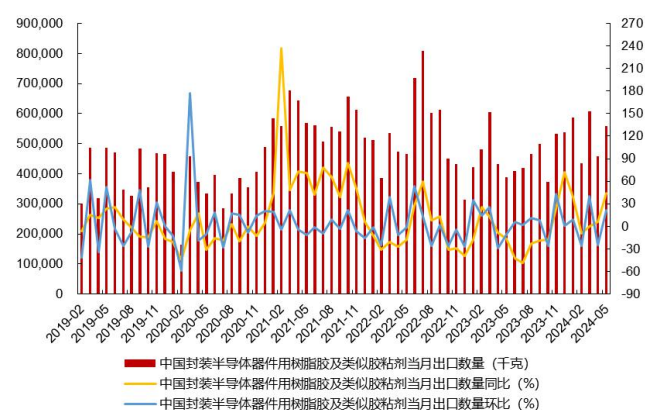
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



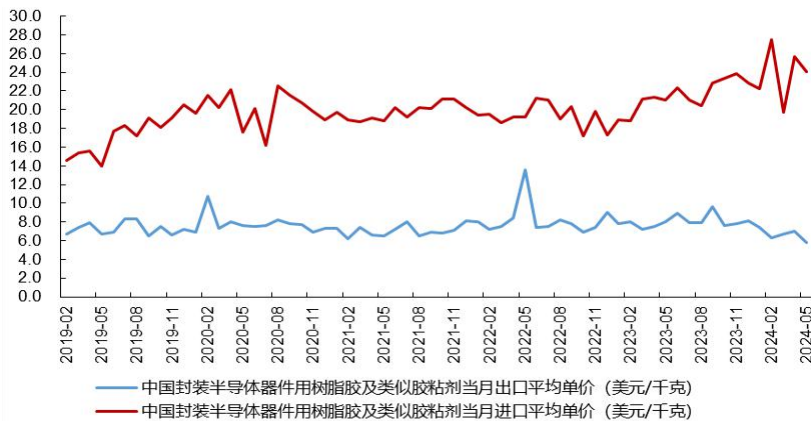
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



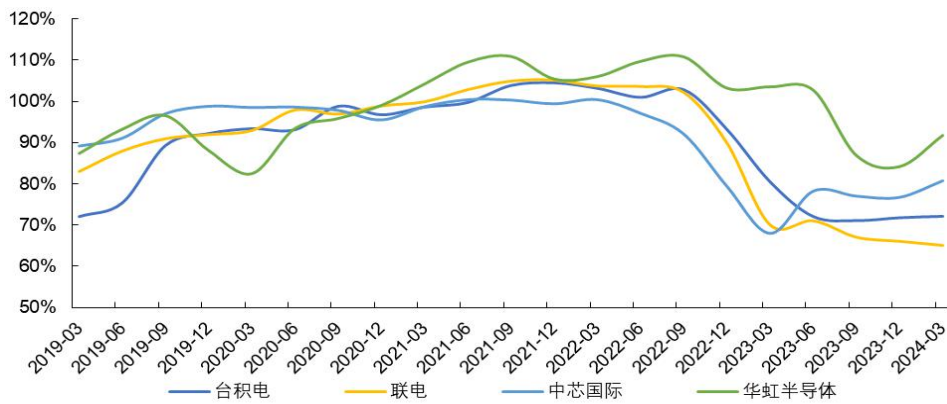
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



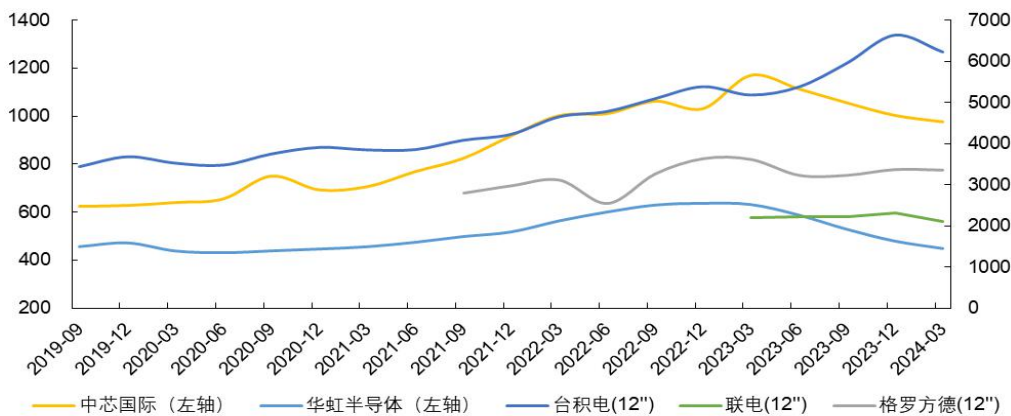
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024 年 7 月 1 日					
2024 年 7 月 2 日		蓝思科技、逸豪新材			
2024 年 7 月 3 日		超频三、达瑞电子、协和电子	思科瑞、中熔电气		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年7月4日		世运电路、恒玄科技、秋田微	芯碁微装、赛微微电、美芯晟、东微半导		
2024年7月5日		乐鑫科技	埃科光电		
2024年7月6日		纳芯微			

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年7月1日	SK 海力士将投资 750 亿美元推进 AI，其中 80% 注入 HBM。 6月30日，韩国 SK 集团宣布，其芯片制造商 SK 海力士将在 2028 年之前投资 103 万亿韩元（约合 750 亿美元）来增强其芯片业务，特别是人工智能开发。103 万亿韩元中的 80%，约合 82 万亿韩元（600 亿美元），将专门用于开发 HBM。HBM 广泛应用于生成式 AI 芯片组，SK 海力士目前是 NVIDIA HBM3 芯片的独家供应商。今年第一季度，SK 海力士营收同比增长一倍多，达到 12.4 万亿韩元，超出市场预期。此外，该公司实现盈利，营业收入为 2.89 万亿韩元，而去年同期则为亏损，这主要是由于 HBM 芯片的高利润率。	TrendForce
2024年7月1日	上游供应链库存回补及需求增温，第三季服务器出货增幅 4-5%。 根据 TrendForce 集邦咨询观察，服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势，其中 Enterprise OEMs 出货拉动最为显著，包含 Dell、HPE 与 Lenovo 均受益明显。除已知的 AI 服务器订单需求畅旺外，近期更受惠于招标项目所驱动，以及 AI 所牵引的储存服务器(storage server)需求助力，推升第二季出货表现，动能将延续至第三季，预估第三季季增约 4-5%。而在中国企业方面，电信商招标项目将在本月展开，因此推升相关业者，如 IEIT 与 xFusion 的订单需求。此外，在 CSPs 动能上，ByteDance 因新业务的需求，拉大全年服务器采购；Alibaba 与 Tencent 也因换机周期，纷纷于近期上修服务器整机订单。	TrendForce
2024年7月2日	英伟达遭遇反垄断调查。 据知情人士透露，英伟达即将因涉嫌反竞争行为而受到法国反垄断监管机构的指控，这将是第一家针对这家计算机芯片制造商采取行动的执法机构。去年 9 月，法国对显卡行业进行了突击检查，消息人士称，针对 Nvidia 的突击检查就是法国所谓的异议声明或指控书。此次突击检查是对云计算进行更广泛调查的结果。如果违反法国反垄断规定，公司将面临高达其全球年营业额 10% 的罚款，不过它们也可以做出让步以避免受到处罚。美国司法部正牵头调查英伟达，并与 联邦贸易委员会分担对大型科技公司的审查。	NASDAQ
2024年7月2日	江波龙宣布全新海外投资计划。 巴西时间 2024 年 7 月 1 日，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”）宣布其巴西子公司 Zilia（智忆巴西）已经开始封装生产江波龙存储产线。这一成功导入标志着江波龙海外并购服务和技术赋能的正式落地，为江波龙向高端、品牌、海外发展提供存储制造竞争力。与此同时，智忆巴西公布了 6.5 亿雷亚尔（约 8.59 亿人民币）的投资计划。这一自筹资金的投资计划将协同江波龙技术、产品和供应链资源优势，主要用于研发创新及产能的进一步扩张，以丰富存储产品组合，并扩大在美洲市场的份额。	公司官网

时间	内容	来源
2024年7月3日	AMD与英伟达需求推动 FOPLP 发展, 预估量产时间落在 2027-2028 年。自第二季起, 超威半导体 (AMD) 等芯片业者积极接洽台积电及 OSAT 业者以 FOPLP 技术进行芯片封装, 带动业界对 FOPLP 技术的关注。FOPLP 技术的优势及劣势、发展机会及挑战并存。主要优势为低单位成本及大封装尺寸, 只是技术及设备体系尚待发展, 技术商业化的进程存在高度不确定性, 预估目前 FOPLP 封装技术发展在消费性 IC 及 AI GPU 应用的量产时间点, 可能分别落于 2024 年下半年至 2026 年, 以及 2027-2028 年。	TrendForce
2024年7月4日	2024 年下半年半导体晶圆厂利用率有望突破 80%。当前, 内存市场表现尤为亮眼, 主要受益于高带宽内存 (HBM) 的旺盛需求以及 AI 数据中心对 NAND 闪存使用量的增长。随着内存市场的逐渐复苏, 2024 年下半年预计将冲破 80%。台积电 5 纳米及以下先进制程的产能利用率已接近饱和, 同时有报道称, NAND 闪存制造商也即将结束减产措施。然而, 工业和汽车市场的情况仍不明朗。模拟芯片、分立器件等领域的制造商在 2024 年上半年被迫削减产量, 成熟技术节点的晶圆厂利用率并不理想。但预计随着库存逐渐消化, 2024 年下半年该领域需求将有所回暖。随着终端需求全面复苏, 2024 年下半年全球晶圆厂利用率有望提升至 80% 左右, 并在 2025 年达到平均 90% 的利用率。	TechInsights

资料来源: Trendforce, NASDAQ, 江波龙官网, TechInsights, 山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

